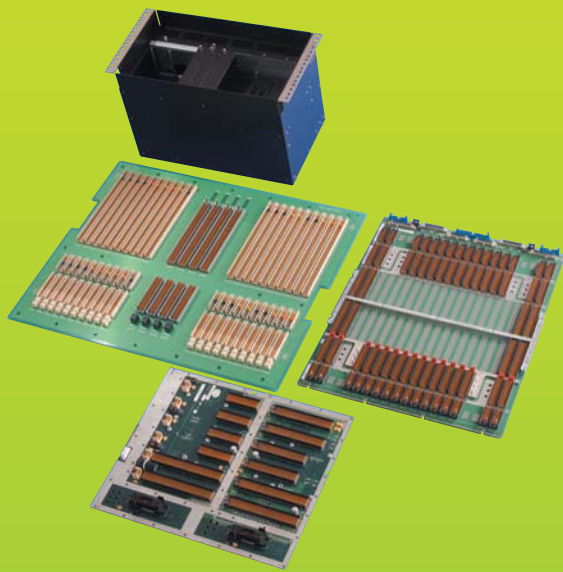


バックプレーンシステム

カスタムバックプレーン

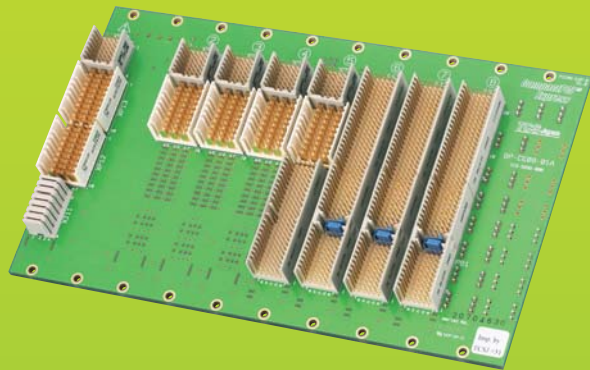


バックプレーン専門メーカーとしてのノウハウをもとに、最新の動向をふまえ、お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案します。また、十分な設計リソースを備え、高信頼性、高密度化が進むバックプレーンシステムに対応。ソリューションの提供を通じて、クォリティーとスピードの両立を徹底しています。

スタンダードバックプレーン

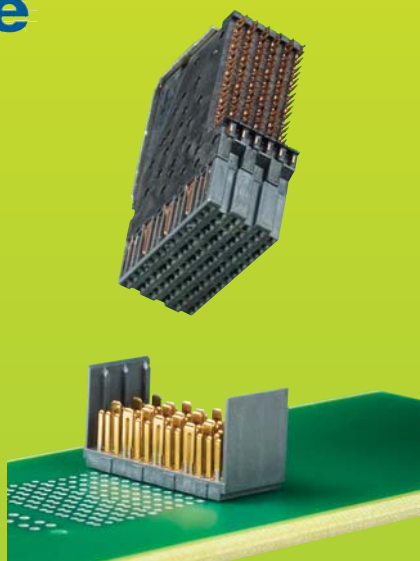
Advanced TCA[®]
CompactPCI[®]

μTCA[™]
CompactPCI[®] Express



長年に渡るカスタムバックプレーンの経験を基に、PICMG 規格の標準バックプレーンシステムの販売を開始いたしました。カタログ品はもちろん、標準規格をベースとしたセミカスタムの要求にも、高い技術力で迅速にお応えいたします。Advanced TCA CompactPCI その他、対応バックプレーンも用意しております。

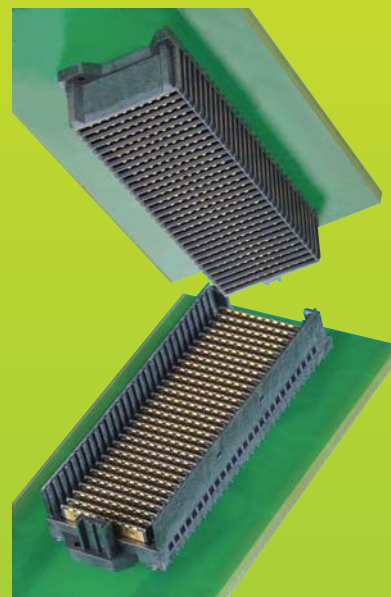
伝送用コネクタ



Cede™ シリーズは、IEEE 802.3ap 20Gbps Compliance に十分なマージンを持って適合する 高速伝送用バックプレーンコネクタです。通常の100ΩZoマッチングバージョンに加え、85Ωバージョンも用意しています。次世代の様々なアプリケーションの要求データレートをサポートいたします。

Ethernet ・ SONET/SDH ・ Infiniband
PCI Express ・ HyperTransport ・ Fiber Channel
SATA

NeXLev[®]



NeXLev[®] は、高速・高密度に対応したBGA実装のスタッキングコネクタです。10~30mmの間で、12通りの実装高の選択が可能です。12Gb/sまでのデータレートに対応します。57リアルシグナル/10mm (シングルエンド) 29実装高/10mm の高密度を実現しています。